

GLP-200W

(2ヘッド3テーブルモデル)
(2-heads and 3-tables model)

難削材対応研削装置

Grinder for Superhard Materials

【概要 - Outline -】

◆難削材等ウエハー (SiC、LT、GaN、AL2O3 等) を高速で高精度に研削する装置です。

Grinding machine which capable to grind wafer of resistant materials (SiC,LT,GaN,AL2O3) which high speed ,high accuracy

【特長 - Features -】

◆非接触研削対応、積層薄膜ウエハー研削等に最適機能

Support Non-Contact grinding. Best function for grinding the laminated thin wafer etc

◆高剛性・高速・高荷重・高精度

High rigidity configuration

◆作業性向上に配慮した機構採用により作業時間大幅短縮

Working time is shortened remarkably by the structure considering the improvement of work efficiency.

◆砥石φ200、φ300 変更可能

Available to change to Dia 200, 300 stones.

◆選べる3つの加工モード

Selectable 3 process mode

◆圧倒的なTTV向上

Dramatic improvement on TTV

※非接触研削はオプション対応

※Non-contact grinding is an option



仕様 Specifications	GLP-200W
加工範囲 Work size	φ100 ~ φ200 (4,6,8inch) (厚み) thickness 100μm ~ 999μm
砥石サイズ Grinding Wheel	Select from size φ200、φ300
スピンドル回転数 Spindle Rotational	MAX 3000RPM
ワークテーブル Work table	Vacuum chuck
装置寸法 Machine dimensions / cell	W 3000mm × D 1400mm × H 2400mm
装置重量 Machine weight / per cell	about 7000 kg
オプション Option	研削液循環システム grinding lubricant circulating system

※製品の仕様・外観・寸法などは、改良の理由により、予告なく変更する場合があります。
Specifications are subject to change without prior notice.